



ガスクリーン

半導体用プロセスガス用フィルター



“ガスクリーン”は、コンパクトな構造のインライン・ガスフィルターです。フィルターメディアにはPTFEメンブレンを使用しており、ハウジングは316Lステンレススチール製で、内面が電解研磨されています。ろ過精度は $0.003\mu\text{m}$ (3nm)であるため、半導体製造プロセスで使用される各種ガスの最終ろ過に最適です。また、長期間の酸素ガスでの使用は、ご推奨致しかねます。^{*1}

^{*1} 長期使用により部品は劣化します。定期的な交換をおすすめします。

特長

- $0.003\mu\text{m}$ (3nm) のろ過精度
- 低い圧力損失
- 全品完全性試験、耐圧およびヘリウムリーク試験済

利点

- パーティクルフリー・ガスの供給
- 大流量処理が可能
- 高い信頼性

材質

構成部品	材質
フィルターメディア	PTFE
カートリッジのハードウェア	ポリプロピレン
O-リング	FEPカプセル・フッ素ゴム
フィルターハウジング	316Lステンレススチール

仕様

ろ過精度 ^{*2}	$0.003\mu\text{m}$ (3 nm) ^{*3}
ろ過表面積 (cm ²)	464
最高使用圧力 (80 °C)	1 MPaG ^{*4}
耐差圧 (21 °C)	正方向 : 0.51 MPa 逆方向 : 0.07 MPa
ヘリウムリーク率 (atm・cc/sec)	$<1 \times 10^{-7}$ (出荷前試験) 1×10^{-9} (設計値)

^{*2} NaClエアロゾル試験による定格付け

^{*3} CNCカウンター (TSI Model 3025) で計測した場合の検出限界値

^{*4} 本製品の設計圧力および製品上の表示は 750 PSIG、5.26 MPaGであり、全品耐圧試験後出荷しています。ただし、日本国内で使用する場合本製品は高圧ガス取締法適合品ではありませんので、ガス用途に使用される場合、最高使用圧力は 1 MPaGとなります。高圧ガス取締法適合品に関しては、当社各営業所までお問い合わせください。

ガスクリーン

製品型式：GLF6101 ①

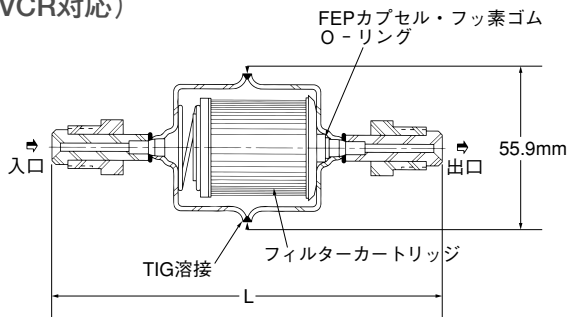
SGLF6101 ①

①

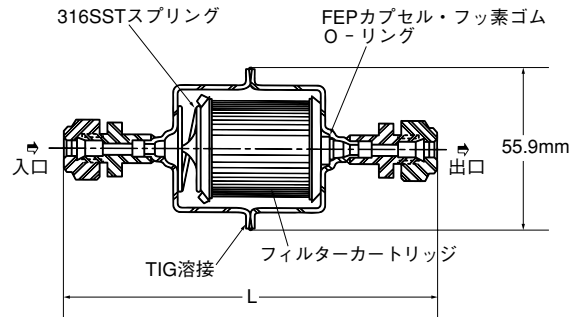
コード	継手	L寸法 (mm)	
		GLF	SGLF
SM4S	1/4" コンプレッションシール(スウェージロック*5対応)	141.3	120.7
SM6S	3/8" コンプレッションシール(スウェージロック*5対応)	147.6	125.4
SM8	1/2" コンプレッションシール(スウェージロック*5対応)	111.1	—
VM4	1/4" ガasketシール、オス (VCR*5対応)	141.3	125.4
VM6/8	3/8" ガasketシール、オス (VCR*5対応)	147.6	—
VM6/8M	3/8" ガasketシール、オス (VCR*5対応)	—	127.0

*5 スウェージロック社の商標

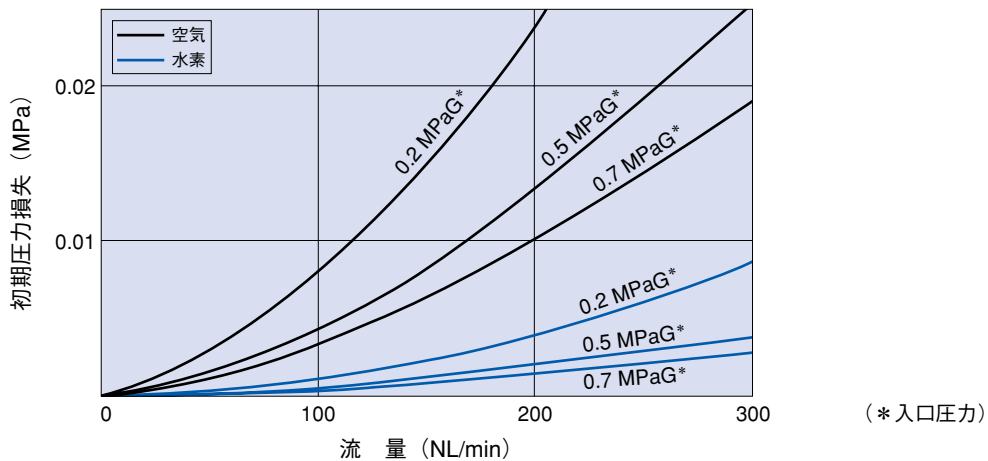
ガスケットシール、オス
(VCR対応)



コンプレッションシール(スウェージロック対応)



流量－圧力損失特性



PALL 日本ポール株式会社

〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1
マイクロエレクトロニクス事業部 TEL.03(6901)5700

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-5-36 TEL.06(6397)3719
熊本営業所 〒862-0956 熊本市中央区水前寺公園 14-22 TEL.096(382)8420

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性については保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。